

2016 年 5 月 16 日

各位

株式会社バイテックホールディングス
バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社
テクノアルファ株式会社

CrucialMachines 社製品の販売に関するお知らせ

レーザーリフロー&TC ボンディング/プローブカード用レーザーボンディング装置の販売

株式会社バイテックホールディングス（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：今野邦廣）の子会社であるバイテックグローバルエレクトロニクス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鈴木 俊幸、以下 VGEL）とテクノアルファ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：青島 勉、以下 TA）は、CrucialMachines 社のレーザーリフロー&TC ボンディング装置、プローブカード用レーザーボンディング装置の販売店契約を締結しました。

CrucialMachines 社のレーザーリフロー&TC ボンディング装置は通常のリフロー炉の代わりにレーザー光を瞬間的に照射する設備で半田を溶解し実装します。レーザー光を用いることで局所的な加熱が可能となるため、リフロー時の課題であった基板への熱ダメージ、基板の反り等の改善が見込まれ、生産性（歩留り）が向上します。さらに CrucialMachines 社の独自技術（TOP-Hat Beam 方式）により基板に対しレーザー光の面照射が可能になるため、通常レーザー半田付け装置と比較し実装時間を大幅に短縮することが可能となりました。

また、CrucialMachines 社のプローブカード用レーザーボンディング装置は、様々なお客様の高い I/O 電極のピッチ、精度及び納期等の要求に対応した製造が可能となり、世界一の精度とタクトタイムを提供致します。

これらの装置を、VGEL はデバイス事業で培った顧客層へ、TA はパワー半導体向け製造装置事業で培った顧客層へ、販売を推進して参ります。また、VGEL と TA は、当該商品の販売とサポートに関する協力体制の強化にも取り組んで参ります。

以上

CrucialMachines 社製ラインナップ

μ-Laser 2D Spring Bonding Machine



Laser Micro Soldering

- Probe Card (Cantilever Pin) Bonding
- Diode/Fiber Laser(1Head/2Head)

μ-Laser Mass Reflow Machine



Laser Mass Reflow

- Si Die to PCB substrate Reflow
- Diode/Fiber Laser

μ-Laser Camera Module Soldering Machine



Laser 3D Soldering

- Camera Module 3D Soldering
- Diode/Fiber Laser

μ-Laser TC Bonding Machine



Laser Thermal Compress Bonding

- Si Die to PCB substrate TC Bonding
- Diode/Fiber Laser

本件に関する問い合わせは

バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社 営業本部

窓口 三橋 亮太 TEL 03-5781-1012 URL <http://www.vitec.co.jp>

テクノアルファ株式会社 経営企画室

窓口 前田 資之 TEL 03-5745-9722 URL <http://www.technoalph.co.jp>